Mould assembly to press-form glass - comprises upper and lower moulds with pattern

faces, each covered by beta silicon carbide film of (III)-oriented face

Patent Assignee: HOYA CORP

Inventors: SASAKI M

Patent Family (2 patents, 1 country)											
Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type				
JP 63045135	A	19880226	JP 1986186462	Α	19860807	198814	В				
JP 1991055421	В	19910823	JP 1986186462	A	19860807	199138	E				

Priority Application Number (Number Kind Date): JP 1986186462 A 19860807

real production of the control of th									
Patent Details									
Patent Number	Kind	Language	Pages	Drawings	Filing Notes				
JP 63045135	Α	JA	4	2					

Alerting Abstract: JP A

Mould assembly comprises upper and lower mould members having pattern faces, each covered with a beta-SiC film having a (111)-oriented face.

USE - For making glass lenses, penta-prisms, corner prisms, etc.

International Classification (Additional/Secondary): C03B-011/00

Original Publication Data by Authority

Japan

Publication Number: JP 63045135 A (Update 198814 B)

Publication Date: 19880226

GLASS MOLD

Assignee: HOYA CORP (HOYA) Inventor: SASAKI MAKOTO Language: JA (4 pages, 2 drawings)

Application: JP 1986186462 A 19860807 (Local application)

Original IPC: C03B-11/00

Current IPC: C03B-11/00|JP 1991055421 B (Update 199138 E)

Publication Date: 19910823

Language: JA

Application: JP 1986186462 A 19860807 (Local application)

Derwent World Patents Index

© 2007 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 4361659

① 特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2) $\overline{\mathbf{Y}}$ 3 - 55421

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 **2000**公告 平成3年(1991)8月23日

C 03 B 11/00

N 7821-4G

発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 ガラス成形型

> 20特 願 昭61-186462

69公 開 昭63-45135

22出 願 昭61(1986)8月7日

@昭63(1988) 2月26日

佐々木 **@発明者** 眞 勿出 願 人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

審査官 雨宮 弘治

1

切特許請求の範囲

1 被成形ガラスをプレス成形する上型と下型と を含有する成形型において、前記被成形ガラスの 表面に対向する前記成形型の型基盤の表面上に、 主として 111 面配向性を有するベータ炭化珪素 5176929 号公報に開示された如く、 β -sicはsicの 膜が被着されたことを特徴とするガラス成形型。 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ガラス(ガラスレンズ、ペンタプリ のプレス成形に用いられるガラス成形型に関す る。

〔従来の技術〕

冷間の研削、研磨を不要とするガラス成形体の プレス成形に用いられるガラス成形型に要求され 15 る条件は、プレス成形時に型面がガラス面にその まま転写されることから、型面が光学的鏡面に加 工可能なこと、高温でも酸化による肌荒れを起こ さないこと、被成形ガラスと接触した時にガラス に耐える機械的強度を持つことなどである。

冷間での研削、研磨が不要なガラス成形体のブ レス成形型として、特開昭47-11277号公報には、 ガラス状カーボンを用いることが開示されている 不安定で、ガラス成形中に引つかき傷を生じ易い 欠点を持つている。また、特開昭60-176928号公 報にはアモルフアス炭化珪素 (A-sic)、アルフ ア炭化珪素 (α -sic)、及びA-sicと α -sicの

2

混合物から選ばれた膜を被着した型が開示され、 またベータ炭化珪素 (β-sic) はプレス成形時 に被成形ガラスと接触した時に融着を起こし易い 旨の開示も成されている。一方で、特開昭60-中では比較的加工がし易い利点がある。

〔発明が解決しようとする問題点〕

ところが、発明者の実験によると、β-sicを 被着した成形型のβ-sic表面の加工(研削・研 ズム、コーナープリズム、コネクターレンズ等) 10 磨) 時に、引つかき傷の生じ易い構造のβ-sic 膜と引つかき傷の生じ難い構造の B -sic膜とが 存在し、単にβ-sic膜というだけでは成形型表 面に被着する膜として適しているとは言えない問 顋点があつた。

つまり、CVD法によつて合成されるβ-sicは 多結晶体で大別すると表面にピラミッド状の凹凸 のあるフアセット状の膜と滑らかなコーン状の膜 とが有り、フアセット状の膜では、膜の研削時に 研削用ダイヤモンドが大きな結晶粒(一般にファ との融着を起こし難いこと、プレス成形時の衝撃 20 セット状の膜の結晶粒の方が、コーン状の膜の結 晶粒よりも大きい)の間に入り込み、膜の研磨を 行つた時に研磨面にダイヤモンド粒が残存した り、或は、これが脱落して穴となつたり、脱落し たダイヤモンド粒による引つかき傷が生じて、型 が、ガラス状カーボンは酸化し易く、構造的にも 25 の表面の面粗度を悪くしたり、ガラスの融着を起 こす原因の一つともなり、離型時に面精度を悪化 させる要因ともなつていた。ところが、コーン状 の膜では、膜表面が滑らかな為に膜の研削時に研 削用ダイヤモンドが結晶粒の間に入り込み難く、

3

面粗度を悪化させる問題点が生じないことが解つ たのである。更に、発明者がX線回析法を用いて 調べたところ、フアセット状の膜は111面配向 性をもつていることが解つた。

(問題点を解決するための手段)

本発明は前記問題点を解決する為に成されたも のであり、少なくとも被成形ガラスの表面に対向 する成形型の型基盤の表面上に主として111面 配向性を有するベータ炭化珪素膜が被着されたこ とを特徴とするガラス成形型である。

(作用)

111面配向性を有するβ-sic膜を被着する ことにより、型の研削時に研削用ダイヤモンド粒 が結晶粒の間に入り込み難く、型の研削・研磨時 に引つかき傷を生じ難い。

〔実施例〕

本発明を実施例に基づき詳細に説明する。第1 図は実施例の型の縦断面図であり、両凸レンズの プレス成形に用いられる型である。1は上型で炭 化珪素の焼決体を直径17㎜、長さ28㎜の円柱状に 20 方パルブ、22は減圧弁である。 加工し、ガラスと対向する面を曲率半径300㎜の 凹面に加工した型基盤1aに、111面配向性を 有するβ-sic膜1bを被着したものを面精度が 100人以下の光学鏡面にダイヤモンド砥石にて加 工したものである。2は下型である。下型2は、25 上型1と同材料、同形状で、2 a は型基盤、2 b は **1 1 1 面配向性を有する** β - sic膜である。 **3** は炭化珪素の焼結体の胴型であり、4は被形成ガ ラスである。

次に、実施例の型基盤1a,2aに111面配 30 向性を有するβーsic膜を被着する方法について 述べる。第2図は、実施例の型の製作111面配 向性を有するβ-sic膜の被着) に用いられる CVD装置の説明図である。縦型の石英反応管 5 それぞれ配置する。石英反応管5の内部にセット したカーポンヒーターを15kw、400kHzの高周波 誘導加熱により所定温度に加熱し、そのカーポン ヒーターからの間接加熱で基体(本実施例におい である。ガス供給系6内の原料ガスはそれぞれ流 量計9a,9b,9cを通つて下部より反応管5 に供給されるが、原料のsicl4用パブラー 10は20 ℃の恒温槽11の中にセットされ、原料ガスsicl。

は流路 12, 13 を通つたH2ガスにより反応管 5内へキャリアされる。sicl、H₂及びC₃H₈を混 合器 1 4 で混合した後、反応管 5 内に導入すると 共に全体のH2量を一定に保つ為に別系統のH2ラ 5 イン(流路15)を用意して直接石英反応管5に 供給する。排気は反応管上部から油回転ポンプ (リキツドシールドタイプポンプ) 16a, 16 bにより行う。油回転ポンプ16a, 16bと反 応管5の間にトラップ17を設け未反応sicl₄及び 10 反応副生成物のHCIを除去する。また、反応管内 の圧力はマノメーター18を用いて制御する。 $sicl_4+H_2(モル比にしてsicl_4:H_2=1:2)$ を 900ml/min及びC₃H₈を60ml/minずつ供給管 1 9 から供給し、H₂を450ml/minずつ供給管 1 5 15 から供給する。基体加熱温度 (Td) 1300℃~ 1650℃、炉内全圧力(Ptot)5Torr~300Torrで

4

表

60分間 β -sic膜を合成した。この合成した β -

sic膜の折出面の配向性をX線回折で調べた結果

を表1に示す。尚、図中20はバルブ、21は3

Ptot(Torr) Td(℃)	5	30	100	300
1300	_	0	0	0
1350	_	0	0	0
1450	×	×	0	0
1550	×	×	0	0
1650	_	×	×	×

ー:析出せず 〇:コーン状 ×:フアセット状

表1から明らかな様にCVD法にて合成される の一方にガス供給系6を、他方に真空排気系7を 35 β - sic にはコーン状(即ち1 1 1 面配向性を持 つ膜)とフアセット状(即ち220面配向性を持 つ膜)とが存在する。こうして得られたβ-sic 膜を付着させた型と同一の研削・研磨条件にて研 削・研磨を行つた結果220 面配向性を有する膜 ては型基盤1a)を加熱する。8はワークコイル 40 では、引つかき傷が生じたものの、111面配向 性を有する膜では、引つかき傷が生じなかつた。 本実施例で用いた装置では、111面配向性を有 するβ-sicを得る為の条件は、基体温度 (Td) 1450℃~1550℃においては、炉内全圧力 (Ptot)

6

50Torr~760Torrが適しており、基体温度 (Td) 1300℃~1350℃においては、炉内全圧力(Ptot) 10Torr~760Torrが適している。尚、本実施例 において使用した炉はHottwall炉である。また、 と比べて離型性が悪い旨の開示があつたが、発明 者が本実施例の型の離型性をテストしたところ、 珪酸塩ガラス [HOYA(株)製:FD6、ガラス転移 温度435℃)、ホウ酸ガラス [HOYA (株)製: NbFD12、ガラス転移温度595℃、ホウケイ酸ガ 10 オンピーム蒸着法、プラズマCVD法、スパッタ ラス〔HOYA㈱製:BSC7、ガラス転移温度565 ℃] ホウケイ酸パリウム系ガラス [HOYA㈱ 製:BaCD15、ガラス転移温度655℃]の何れの ガラスにおいてもαーsic膜を被着した型と比べ が認められなかつた。

原料ガス源は、Si源としてはsicl、が望ましい 11, SiH4, Si2, H6, Si3, H8, SiH2, Cl2, SiH₂Cl, Si(CH₂)₄, SiH₂(CH₃), SiCH₃Cl₃, SiF(CH₃)₃等の珪素化合物でも良く、また、C源 20 面配向性を有するβ-sic膜。 としてはC₂H₈が望ましいが、CH₄, C₂H₆,

CaHa, CaHa, ベンゼン等の炭化水素や、CCI4 などでも良い。

本例においては、炭化珪素の焼結体を型基盤と して用いたが窒化珪素、炭化チタン、炭化タング 特開昭60-176929号公報には、 β $-\mathrm{sic}$ は α $-\mathrm{sic}$ 5 ステン、窒化タングステン、窒化ホウ素等の金属 の炭化物や金属の窒化物、400系列のステンレス 鋼、無電界ニツケル、ベリリウムーニツケル合金 等の材質でも良い。また、成膜方法は本例では CVD法を用いたがイオンプレーティング法、イ リング法等の手段を用いても良い。

〔発明の効果〕

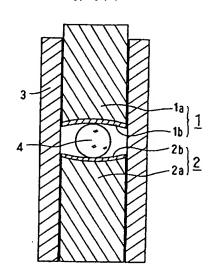
本発明によれば、111面配向性を有する β – sic膜を被着することから、型の研削・研磨時に て離型性(換言すると融着の起こし易さ)の差異 15 引つかき傷を生じ難いガラス成形型が得られる。

図面の簡単な説明

第1図は実施例の成形型の縦断面図、第2図は 実施例に用いたCVD装置の説明図である。

1a, 2a······型基盤、1b, 2b······111

第1図



第2図

